



⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A)

昭64-71087

⑫ Int. Cl.

特許記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和64年(1989)3月16日

H 01 R 33/76

8749-5E

H 01 L 23/32

A-8728-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 ICソケット

⑮ 特 願 昭62-227900

⑯ 出 願 昭62(1987)9月10日

⑰ 発 明 者 森

豊

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内

⑱ 出 願 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

⑲ 代 理 人 弁護士 井 裕 貞一

明 細 書

1. 発明の名称

ICソケット

2. 特許請求の範囲

プリント基板とICパッケージを接続するICソケットであって、接続用の接触部(13a)を配して放電部(13a)より突出した放電用の接触部(13b)を形成した電源用コンタクト(13)と、

接続用の接触部(13a)を有するコンタクト(3)を備え、

絶縁体(2)の上記ICパッケージ(1)に配設された電源ピン(1-1)と対向する位置に上記電源用コンタクト(13)を配し、信号ピン(1-2)と対向する位置に上記コンタクト(3)を配置して、該ICパッケージ(1)の挿入時には該電源ピン(1-1)と上記放電用の接触部(13b)が最初に接触するように構成されてなることを特徴とするICソケット、

3. 発明の他の特徴

【 概 要 】

電子機器の回路接続に広く使用されるICソケットに関し、

「ICパッケージ」の挿入時には先に電気が接続されて帯電した静電気を除去して、その後には回路と接続できることを目的とし、

接続用の接触部を配して該接触部より突出した放電用の接触部を形成した電源用コンタクトと、接続用の接触部を有するコンタクトを備え、絶縁体の上記ICパッケージに配設された電源ピンと対向する位置に上記電源用コンタクトを配し、信号ピンと対向する位置に上記コンタクトを配設して、該ICパッケージの挿入時には該電源ピンと上記放電用の接触部が最初に接触するように構成する。

【 産業上の利用分野 】

本発明は各種電子機器に広く使用されるICソケットに関するものである。

最近、各種電子機器にはICパッケージ、MPU等